

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月6日

【会社名】 株式会社RS Technologies

【英訳名】 RS Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 方 永義

【本店の所在の場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,760,368,500円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であり、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	242,000株	完全議決権株式であり、株主の権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。

(注) 1 平成30年3月6日(火)開催の取締役会決議によります。

2 本募集とは別に、平成30年3月6日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,220,000株の新株式発行に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を予定しておりますが、その需要状況等を勘案し、242,000株を上限として、一般募集の主幹事証券会社である株式会社SBI証券が当社株主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。

株式会社SBI証券は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成30年4月13日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、株式会社SBI証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

株式会社SBI証券は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

株式会社SBI証券が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、株式会社SBI証券はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、株式会社SBI証券による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、株式会社SBI証券は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

3 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	242,000株	1,760,368,500	880,184,250
一般募集			
計(総発行株式)	242,000株	1,760,368,500	880,184,250

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の通りであります。

割当予定先の氏名又は名称		株式会社SBI証券	
割当株数		242,000株	
払込金額		1,760,368,500円	
割当予定先の内容	住所	東京都港区六本木一丁目6番1号	
	代表者の役職氏名	代表取締役 高村 正人	
	資本の額	48,323百万円	
	事業の内容	金融商品取引業等	
	大株主	SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数 (平成29年12月31日)	
		割当予定先が保有している当社の株式の数 (平成29年12月31日)	
	取引関係等	一般募集の主幹事会社	
	人的関係等		
当該株式の保有に関する事項			

- 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われなない場合があります。
- 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
- 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	100株	平成30年4月13日(金)		平成30年4月18日(水)

(注) 1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

- 2 全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。
- 3 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
- 4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとし、

(3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社RS Technologies	東京都品川区大井一丁目47番1号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 五反田支店	東京都品川区東五反田一丁目14番10号

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,760,368,500	8,620,000	1,751,748,500

(注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

- 2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われないう場合、上記金額は、変更される場合があります。
- 3 払込金額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限1,751,748,500円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額8,821,645,000円と合わせた手取概算額合計上限10,573,393,500円について、当社が中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の3,573,393千円については、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に2,473,393千円をそれぞれ充当します。

上記の北京有研RS半導体科技有限公司へ出資した借入金および出資資金の目的としましては、成長性が高いと考える中国の半導体市場に参入するためであります。当社としては、成長性が高いと考える中国の半導体市場に参入するために有力なパートナーと提携し、プライムウェーハ製造販売事業への展開を図るというニーズがありました。一方で、北京有色金属研究総院としては当社のマネジメント力、ウェーハ加工技術を活かし、今後成長する中国の半導体市場において、プレゼンスを握りたいというニーズがありました。両社のメリットについて協議した結果、この度2018年1月に北京有色金属研究総院及び中国現地投資会社である福建倉元投資有限公司と三社間で合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司を新設し、それに伴い北京有色金属研究総院の100%子会社である有研半導体材料有限公司を連結子会社化し中国の半導体市場参入を実現しました。

ウェーハ増産の経緯としましては、当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハ再生事業(半導体製造過程で発生するモニタウェーハ(1)の再生を行う事業)において、新興国の経済発展及び先進国の更なるデバイス用途(車・医療・環境・家・町・データセンター・IoT・M2M(2))の広がり等を背景とした半導体需要が拡大していることによるものであります。

上記調達資金の充当時期につきましては以下を予定しておりますが、具体的な支払が発生するまでは安全性の高い銀行預金等により資金管理を図る予定です。

- 1 モニタウェーハ：半導体製造過程のモニタリングを実施するために使用するウェーハ。
- 2 M2M：Machine to Machine(マシン・ツー・マシーン)の省略形で、機器間の通信を意味しております。

(単位：千円)

項 目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年12月期	平成31年12月期	平成32年12月期
借入金の返済資金	4,200,000	4,200,000		
中国の合弁会社への出資資金	2,800,000		1,750,000	1,050,000
ウェーハ増産に係る設備投資資金	3,573,393		3,573,393	
調達による充当額合計	10,573,393	4,200,000	5,323,393	1,050,000

上記ウェーハ増産に係る設備投資資金3,573,393千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在(ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月	
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
艾爾斯半導體 股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
有研半導体材 料有限公司	北京工場 (中華人民共和 国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ 製造設備	2,473,393		増資資金	平成31年 1月	平成32年 1月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

第7期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月29日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

第8期 第1四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年5月15日関東財務局長に提出

第8期 第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) 平成29年8月10日関東財務局長に提出

第8期 第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月14日関東財務局長に提出

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)までに、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出

(平成29年3月31日提出の臨時報告書)

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書

(平成29年12月21日提出の臨時報告書)

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された『事業等のリスク』及び『設備の新設、除却等の計画』について、以下のとおり、追加いたします。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

『事業等のリスク』

(1) M&A、事業提携に関するリスク

当社グループは、今後の業容拡大等においてM&A及び事業提携戦略は重要かつ有効であると認識しております。M&Aや事業提携を行う場合においては、対象会社を慎重に検討し、対象会社の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努める方針としておりますが、買収後に偶発債務の発生等、未認識の債務が判明する可能性も否定できません。また、のれんが発生する場合はその償却額を超過する収益力が安定的に確保できることを前提としておりますが、買収後の事業環境や競合状況の変化等により買収当初の事業計画遂行に支障が生じ、計画どおりに進まない場合は当該のれんに係る減損損失等の損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

『設備の新設、除却等の計画』

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)	着手	完了	
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約10%増
艾爾斯半導體股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約30%増
有研半導體材料有限公司	北京工場 (中華人民共和国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ製造設備	9,473,393		平成31年 1月	平成32年 1月	現状の約300%増

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導體材料有限公司北京工場への設備投資予定額9,473,393千円に関しては、中国の合併会社である北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合併会社への増資資金)および2,473,393千円(有研半導體材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となっております。

なお、北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により賄ってありましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社RS Technologies 本店

(東京都品川区大井一丁目47番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

該当事項はありません。